

【原因、判断要点、发生工序】局部镀金层的边界受到镀金液的侵蚀，减弱了 PSR 与铜层的结合强度而引起的。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a weakened adhesion of photo solder resist to conductive copper due to the etching of conductor by gold plating solution at the boundary of p locally plated gold deposit.



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

2-3-2-6 回路欠陥部 SR 不付 / SR 在线路缺陷部位不黏结 / No solder resist on conductor defect

【特徴】回路欠陥部に S R が塗布されていない状態の欠陥

【特征】在线路缺陷部位不能涂布 SR 的缺陷。

【Characteristics】Solder resist does not coat a conductor defect.

【原因・判断ポイント・発生工程】導体回路の凹凸欠陥などの部分に、S R インクが塗布されなかった為に出来たもの（導体回路形成前～S R 塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】在线路凹凸缺陷等的部位不能涂布 SR 而引起的（图形转移前～涂布 SR 工序）

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by the absence of solder resist ink on an uneven surface of a conductive pattern (Before conductor pattern formation - solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 60

【注釋】
显微镜倍率 × 60

【Comments】
Magnification: ×60



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

2-3-2-7 SR 静電気むら / SR 因静电而不均匀 / Uneven solder resist surface caused by electrostatic discharge

【特徴】リング状の導体盛り上がり部の内側の S R 厚が薄く、片方の外側 S R 厚が流星状に厚くなっている色むら

【特征】在导线的环状鼓起部位 SR 厚度变薄、单向的外侧 SR 厚度变厚，像流星那样颜色深浅不匀。

【Characteristics】Solder resist is thin on the inside of the ring-shaped rising of a conductor pattern and thick in the form of a meteor on one side of the outside of the ring, which makes the colour of solder resist look uneven.



【コメント】
静電気破壊により熔融した銅がリング状に飛散してできたダム
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
由于静电破坏，熔融的铜环状地飞溅并发生凹陷
显微镜倍率 ×

【Comments】
A dam made by splashing of molten copper by electrostatic discharge in a ring form
Magnification: ×